

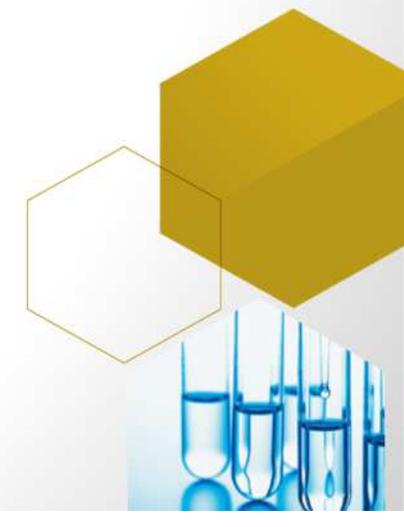
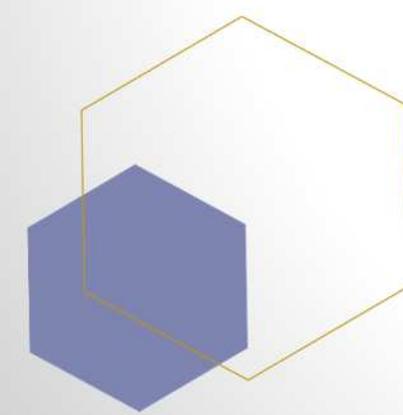
2024年3月期 第3四半期 決算説明資料

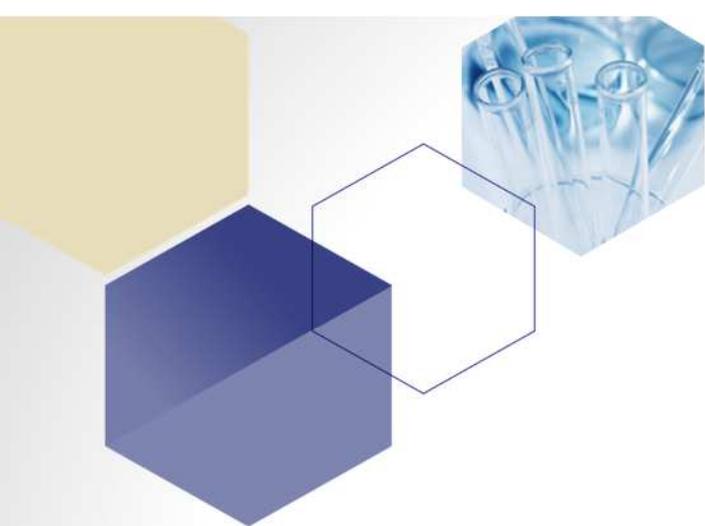


日本高純度化学株式会社

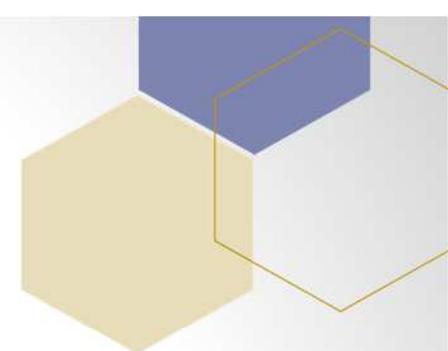
証券コード：4973

2024年1月26日

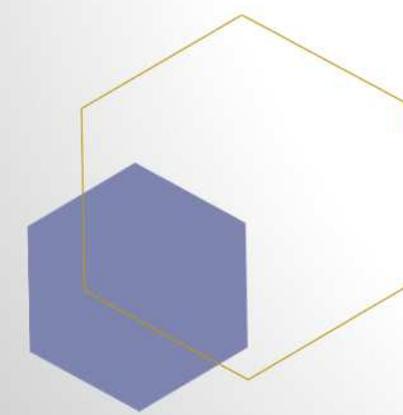
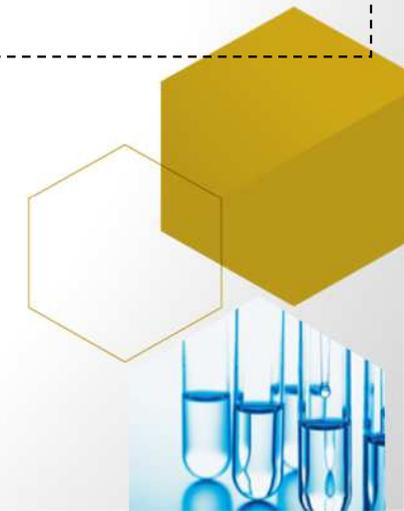




決算の概況



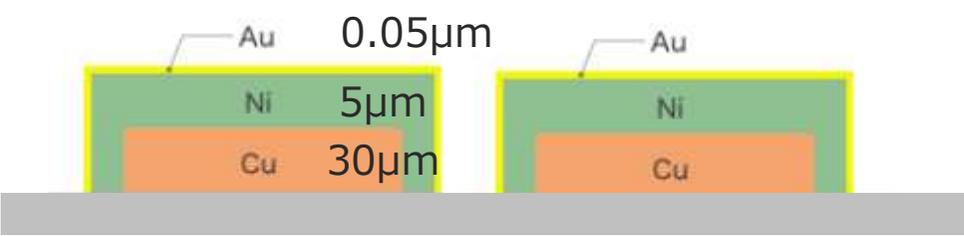
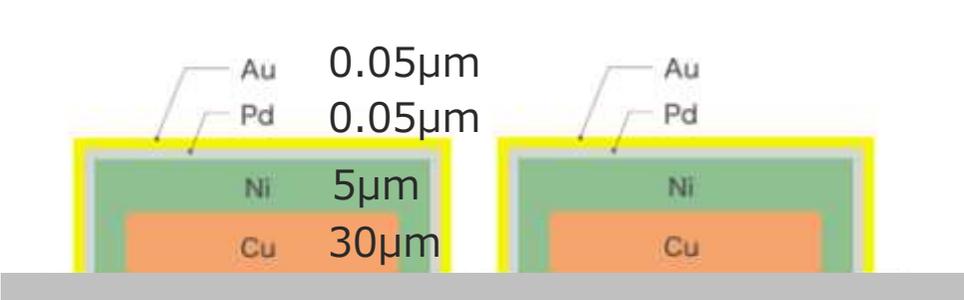
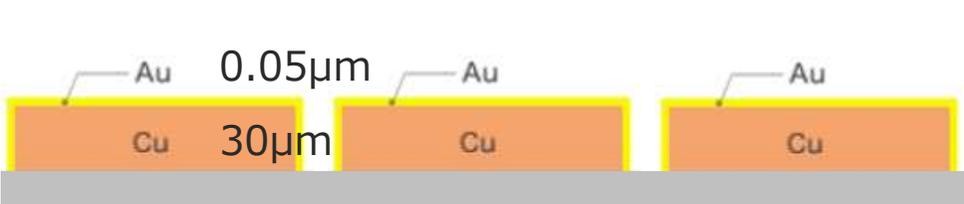
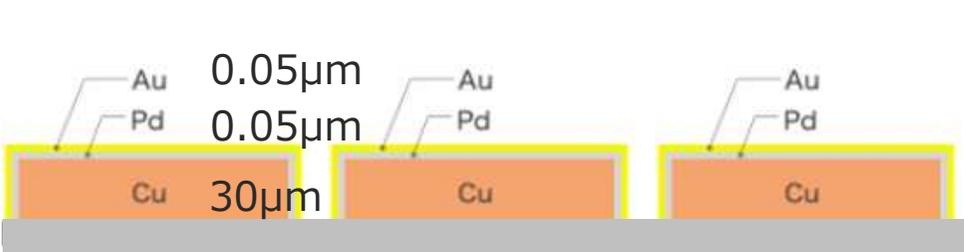
(注) 当社業績の見方のポイント

- ▶ 売上高は、薬品と一緒に貴金属を販売する場合と、薬品のみを販売する場合とで大きく変動します。
 - ▶ 貴金属は、価格変動があり、かつ高価なため、売上高に大きく影響します。
- 
- 

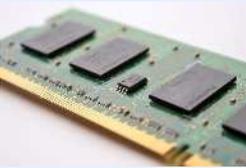
用語説明①（めっき方式）

用語	用途	説明
電解めっき （電気めっき）	—	金属などの表面に電気を流してめっきする方法
純金めっき	プリント基板 半導体搭載基板	高純度な純金めっき
硬質金めっき	コネクタ プリント基板	合金成分を入れて硬くした合金めっき
パラジウム （Pd）めっき	リードフレーム コネクタ	金めっきの下地めっきとして使用される
無電解めっき	—	電気を流さず化学反応によりめっきする方法
置換めっき	プリント基板	金属ごとの溶けやすさ（イオン化傾向）を利用し、下地金属の表面を置き換えて形成するめっき方法
還元めっき	プリント基板	還元剤による化学反応を利用し、厚く形成できるめっき方法

用語説明② (めっきプロセス)

用語	説明	めっき層構成
ENIG	銅上に無電解ニッケルめっき及び置換金めっきをする方法。Electroless Nickel Immersion Goldの略 層構成はCu-Ni-Au	
ENEPIG	銅上に無電解ニッケルめっき、無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法。Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Goldの略 層構成はCu-Ni-Pd-Au	
DIG	銅上に置換金めっきを直接する方法。Direct Immersion Goldの略 Niめっきを省いているためENIGに比べファインピッチ対応が可能。層構成はCu-Au	
EPIG	銅上に無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法。Electroless Palladium Immersion Goldの略 層構成はCu-Pd-Au	

製品ラインアップ ～ラインアップ拡充と新分野開拓～

めっき方式		用途	製品ラインアップ	
電解	純金		① 粗面上でも均一な膜厚が得られる純金めっき ② 硬度の高い純金めっき	
	硬質金 (合金)		マイクロコネクタ用省金硬質金めっき	オーロブライト BAR7
	パラジウム(Pd)		PPF用薄膜パラジウムめっき (PPF: Pre Plated Lead frame)	パラブライト NANO2
無電解	置換金		中～高リンニッケルで使える置換金めっき 下地ニッケルの腐食が少ない置換金めっき ニッケル不使用置換金めっき	IM-GOLD IB2X IM-GOLD CN IM-GOLD PC
	還元金		亜硫酸金を使った薄膜還元金めっき シアン化金を使った薄膜還元金めっき	HY-GOLD HY-GOLD CN
	還元Pd		ENEPIG用還元パラジウムめっき ニッケル不使用還元パラジウムめっき	ネオパラブライト 2 ネオパラブライト DP

周辺分野

卑金属（銅、スズ、ニッケル）
合金めっき 後処理剤など

2024年3月期 第3四半期決算概況

電子部品業界の状況

- 中国経済の景気減速や欧米における金利高止まりの影響から、スマートフォンやパソコンなどの民生向けにおいては需要の底を打ったものの弱含みで推移
- クラウド/データセンター向けや半導体装置／FA機器などの産業機器向けにおいては、生成AI向けで堅調な需要がみられたが、投資抑制の姿勢から低調に推移
- 車載用電子部品については、半導体不足の解消が進み、自動車の電装化や電気自動車へのシフトに伴う継続的な需要増から回復が鮮明になってきた

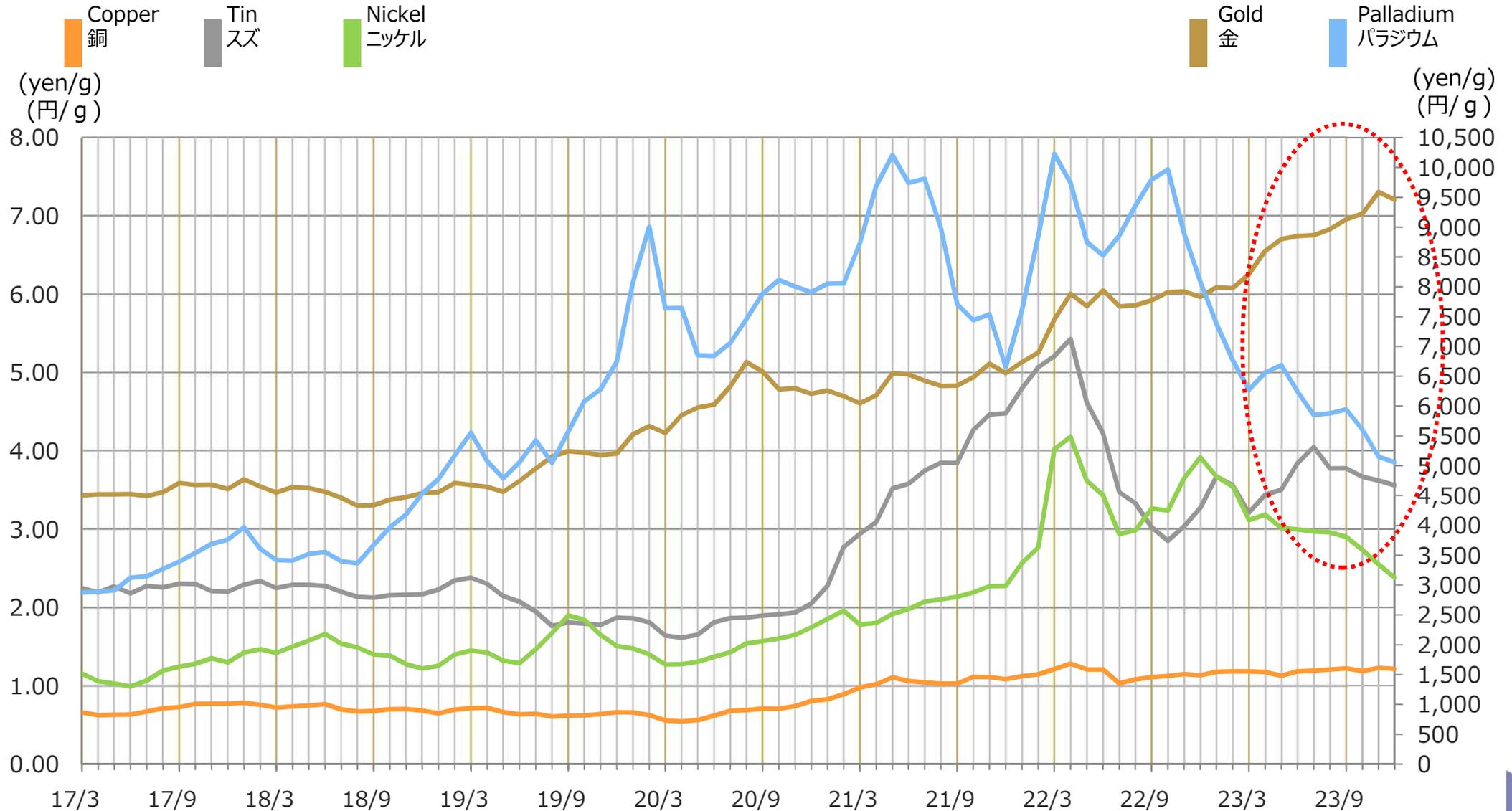
当社決算の概況

- プリント基板・半導体搭載基板用めっき薬品
生成AI向けなど一部の最先端半導体パッケージ向けで堅調な需要が見られたものの、スマートフォンやパソコン向け、およびこれらのメモリ向けで生産調整が見られ、緩やかな需要回復に留まる
- コネクタ用めっき薬品
車載向けで需要回復が見られたが、中華系スマートフォンや産業機器で需要が低迷し、低調に推移
- リードフレーム用めっき薬品
スマートフォンやパソコンでの需要回復は弱含みに推移し、パラジウム価格下落の影響もあり減収

メタル相場推移

Prices of copper, tin and nickel
銅、スズ、ニッケル価格

Prices of gold and palladium
金、パラジウム価格



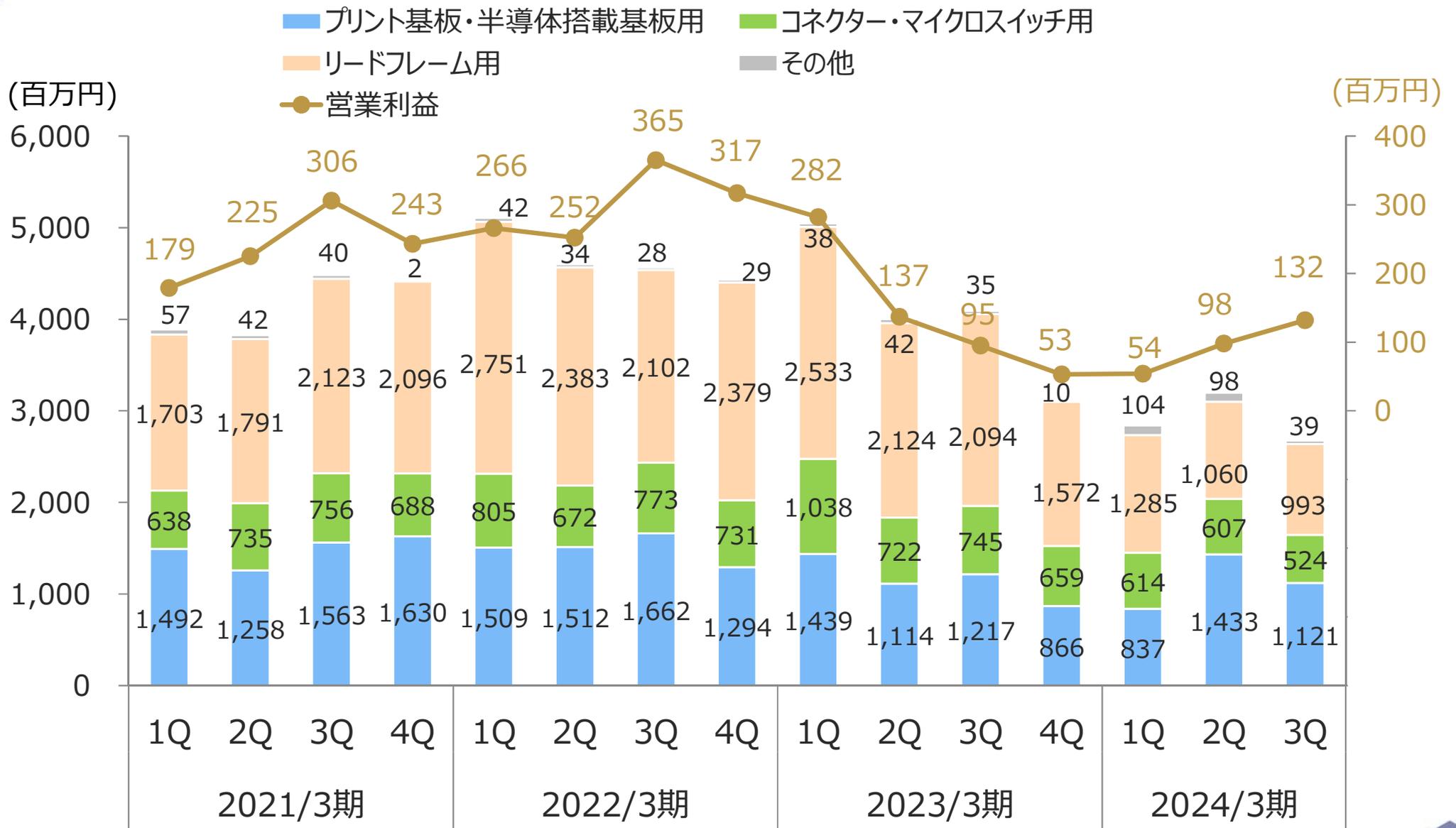
2024年3月期 第3四半期決算概況

(単位：百万円、%)

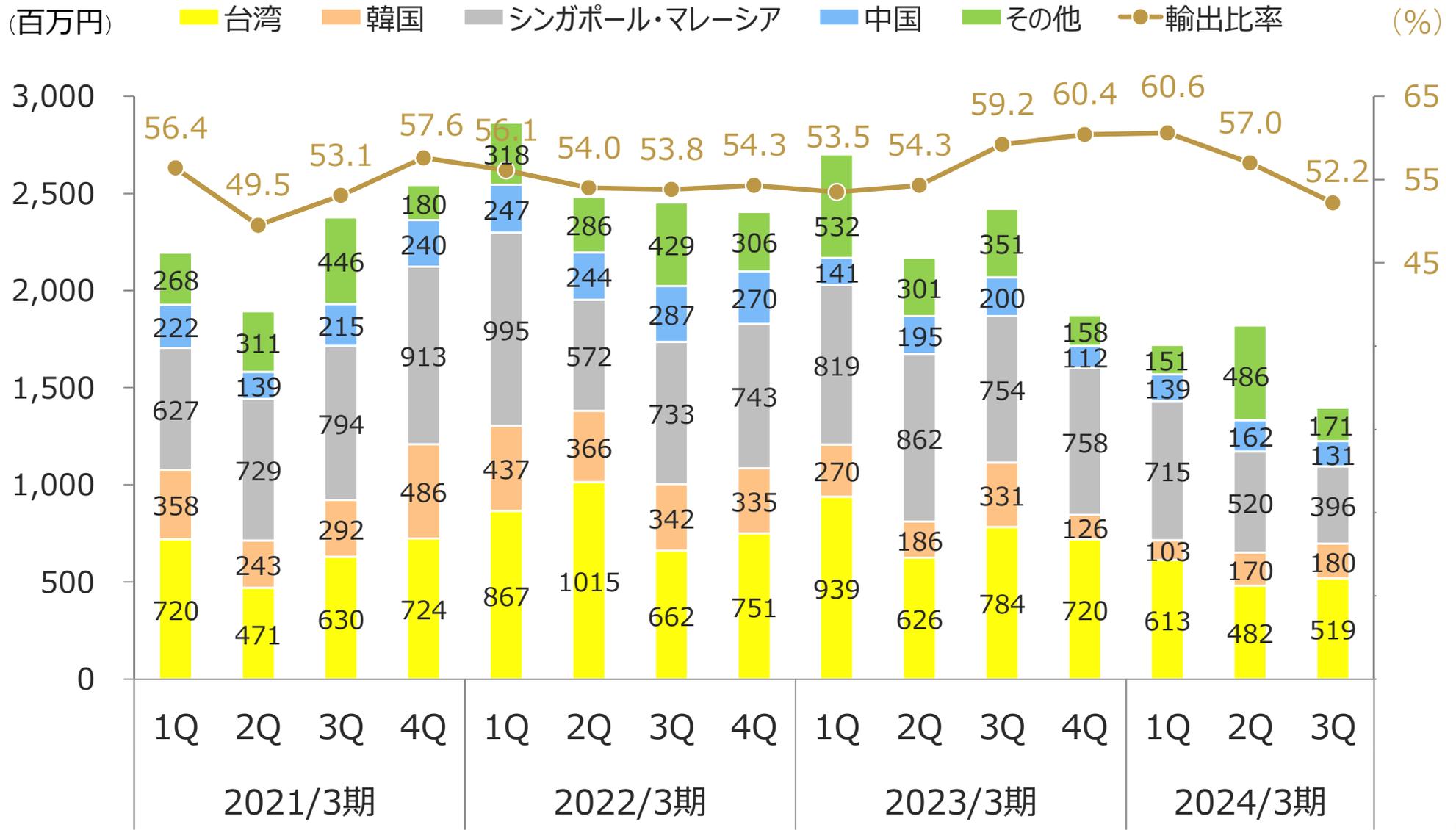
	2023/3期 1Q~3Q	2024/3期				
		1Q	2Q	3Q	1Q~3Q	増減率
売上高	13,146	2,843	3,199	2,679	8,721	△33.7%
営業利益	514	54	98	132	285	△44.6%
経常利益	696	154	108	216	479	△31.2%
四半期純利益	496	119	83	168	370	△25.3%
1株当たり 四半期純利益	84.87円	20.74円	14.42円	29.28円	64.45円	—

- スマートフォンやPCなどの民生品、およびサーバ/データセンター向けのめっき薬品について、緩やかな需要回復に留まり、前年同期比で減収減益

売上高・営業利益の推移（四半期ベース）



輸出地域別売上高の推移（四半期ベース）



2024年3月期 通期見通し

(単位：百万円、%)

	2023/3期	2024/3期		
		期初公表値	通期見込み	増減
		(2023年4月)	(2023年10月)	前期比
売上高	16,254	16,500	13,500	△16.9%
営業利益	567	700	510	△10.2%
経常利益	753	850	710	△5.8%
当期純利益	569	600	520	△8.8%
配当	80円	80円	100円	+20円
ROE	4.1%	4.5%	3.9%	—

- 車載向けは年間を通して堅調な推移を予想
- スマートフォンやP Cなどの民生品およびサーバー/データセンター向けの需要は想定よりも弱含みで、産機向けは中国経済の景気減速などにより低調な推移を予想
- D O E の採用に伴い、配当は年間100円（うち中間40円）

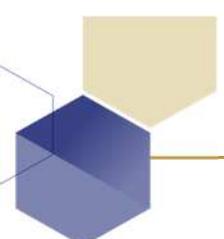
補足資料：会社紹介

沿革

- 1971年 7月 会社設立
- 1999年 11月 MBOを実施
- 2002年 12月 JASDAQ市場に上場
- 2004年 3月 東京証券取引所市場第二部に上場
- 2005年 3月 東京証券取引所市場第一部に上場
- 2019年 2月 一般財団法人JPC奨学財団設立
- 2020年 4月 公益財団法人JPC奨学財団に認定
- 2022年 4月 東京証券取引所プライム市場に移行

事業概要

- 電子部品業界の発展を支える電子材料を供給するファインケミカル企業
- 事業のターゲットを貴金属めっき薬品に絞り世界シェアトップクラス
- 変化の激しい業界にスピーディーに対応できる販売体制と技術サポート体制を構築
- 大規模な製造プラントを必要としないファブレス企業
- 電子部品の接続に用いる貴金属の使用量を最小限に抑える技術を提供し、資源の有効利用に貢献



注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2023年12月時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画部

<https://www.netjpc.com>